

各 位

2023 年 10 月 31 日
SBI ホールディングス株式会社
JSMC 株式会社

日本国内での半導体ファウンドリ建設予定地決定のお知らせ

SBI ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝、以下「当社」）と台湾の半導体ファウンドリ大手 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation（代表取締役会長：黄 崇仁、以下「PSMC」）は、このたび宮城県黒川郡大衡村、第二仙台北部中核工業団地（以下、第二仙台北部中核工業団地）を半導体ファウンドリの建設予定地として決定し、当社、PSMC、JSMC 株式会社（本社：東京都港区、共同代表：宮崎 誠、呉 元雄、以下「JSMC」）及び宮城県の 4 者で、政府から一定以上の補助金を受領することを前提とし、上記予定地における半導体工場の建設に向けた基本合意書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

当社と PSMC は本年 8 月に日本国内での半導体ファウンドリ設立に向けた準備会社として JSMC を設立し、工場の建設地の検討を進めてまいりました。

工場建設計画の発表以降、30 を超える自治体から誘致の申し出を賜り、工場用地のインフラ整備、様々な経済条件含め、非常に建設的なご提案を頂戴いたしました。誘致に立候補いただき、さまざまなご配慮を賜りました自治体の皆様には、改めまして厚く御礼申し上げます。

候補地自治体との協議、現地視察を重ねた結果、給排水、高圧電力、ロジスティック等のインフラの充実度、災害への強度、周辺の住環境、今後の産官学連携の可能性等を踏まえ、第二仙台北部中核工業団地を建設予定地として決定いたしました。

多くの半導体企業は最先端または先端技術に特化した投資をしていますが、PSMC は車載向け半導体需要の 90%以上を占めるとされている 28nm 以上の半導体を高品質で安価・大量に生産するビジネスモデルのノウハウを有しております。建設予定の工場では最終的に、これら 28nm、40nm、55nm の半導体について、月間 4 万枚のウェハ*を生産できるよう計画しています。

今後、日本政府の推し進める半導体・デジタル産業戦略の下で、宮城県をはじめとした自治体、協力企業、協力金融機関等と連携しながら、第二仙台北部中核工業団地での工場建設に向けて、資金調達を含めたより具体的な計画を検討してまいります。工場の建設開始時期や稼働時期などの詳細については、決定次第改めて発表させていただきます。

当社は「金融を核に金融を超える」という理念のもと、様々な産業の発展にも波及する、日本の半導体産業の再興に向けて貢献してまいります。

*ウェハ：半導体の材料として用いられているシリコン単結晶でできた薄い板であり、1 枚のウェハから多くの半導体チップが切り出されます

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126